

For ENGLISH Version – please scroll down!!

Zur Prüfung auf Vollständigkeit der Fertigungsunterlagen ist nachfolgende Prüfsequenz durchzuführen. Fehlende Dokumente müssen vom Auftraggeber gegebenenfalls zur Verfügung gestellt werden.

1. Zur Fertigung von elektronischen Baugruppen müssen Layout-Dateien für die Platinenherstellung, im Extended Gerber Format (RS-274-X) vorliegen.

Diese beinhalten:

- a. Alle Lagendaten
 - b. Bestückungsdruck Top / Bottom
 - c. Maske für Lötstopplack Top / Bottom
 - d. Bohr- und Fräsdaten
 - e. Mindestens 3 Fiducials
 - f. Optional: Nutzenaufbau
2. Zur Bestückung von SMD Bauteilen über einen Bestückautomaten müssen XY-Positions-Koordinaten sowie deren Drehwinkel im Text oder MS Excel Format vorliegen
 3. Software für programmierbare Bausteine, falls diese durch Contec zu programmieren sind
 4. Zur Bearbeitung oder Anfertigung von Frontplatten, Gehäusen oder anderen mechanischen Bauteilen müssen technische Zeichnungen mit allen Maß- und Materialangaben vorhanden sein
 5. Zum Bedrucken von Frontplatten oder Gehäusen müssen geeignete Vorlagen im „DXF“ Format vorliegen.
 6. Im Fall von besonderen Arbeitsvorgängen werden die dazu entsprechenden Arbeitsanweisungen oder Bauvorschriften benötigt.
 7. Falls Etiketten kundenindividuell bedruckt werden sollen, sind die entsprechenden Vorgaben erforderlich.
 8. Falls keine Standard ESD-konforme Verpackung gefordert wird, müssen die entsprechenden Verpackungsvorschriften bereitgestellt werden
 9. Für Funktionstest werden entsprechende Teststände, Testsoftware sowie Testanweisungen benötigt
 10. optional hilfreich: Foto oder Muster der zu fertigenden Einheiten.

For your convenience, please find below the check list regarding documents and information we require as a prerequisite to start with manufacturing.

1. In case of PCB manufacturing a complete set of layout files in extended Gerber format (RS-274-XL) is required and should contain at least.
 - a. a) Layout data for all PCB layers
 - b. b) Silk Screen Top / Bottom
 - c. c) Soldering masks Top / Bottom
 - d. d) All drill and mill data
 - e. e) At least 3 fiducials
 - f. f) optional: panel drawings
2. In order to set-up the SMD pick and place machines, please provide XY-coordinates and angular positions for all SMD components either in .xls or .text format.
3. Provide Software images and instructions in case firmware needs to be programmed.
4. In case of front panels, housings or other mechanical parts, please provide the technical drawings with all dimensions and material specifications.
5. If silk screen-printing for front panels or housings is required, please provide the corresponding images in ".DXF" format.
6. All work instructions and guidelines, especially in case specific process steps are required.
7. In case individual labels are required, please specify the respective content.
8. If no standard ESD packaging is required please provide the respective packaging instructions.
9. For functional tests we need the specific test equipment (test stand), all test instructions as well as the corresponding software.
10. As an option, a picture or a sample of the unit to be manufactured would be very helpful.